



本社：〒160-8366

東京都新宿区西新宿 6 丁目 24 番 1 号
西新宿三井ビルディング

報告書番号：PCN#20110429000

2012 年 11 月 12 日

お客様各位

日本テキサス・インスツルメンツ株式会社
営業・技術本部 カスタムドキュメント
マネージャ 牧 達郎 

STATSChipPAC 社製造 PBGA パッケージ 一部製品 代替 Substrate 部材追加取消のご案内

(初版 PCN20110429000 2011 年 4 月 29 日発行)

拝啓 貴社益々ご清栄の事とお喜び申し上げます。平素は弊社製品のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。さて、標題の件につきましてご連絡させていただきます。ご査収の程、宜しく願い申し上げます。

今回のお知らせは、変更取消についての連絡になります。本変更は実施されません。詳細は、次頁以降をご参照下さい。

本通知は、いかなる製品の製造終了に関する状況を変更するものではございません。既に製造終了の連絡をさせていただいている場合には、本通知によって、既通知の最終受注日及び最終出荷日が延長されることはございません。

お客様におかれましては、本通知発行日後、**30** 日以内に通知確認のご連絡をお願いいたします。お客様の受領連絡は PCN 担当マネージャ或いは担当営業にご連絡下さい。

本通知は、通知日前 24 ヶ月以内に本変更対象製品をご購入いただいたお客様に連絡させていただいております。

尚、ご不明な点、ご質問等がございましたら、担当営業或いは pcn_tij@list.ti.com にお問い合わせ下さい。

以上

変更概要

通知タイプ	☐ Initial notice (Plan)		☒ Final notice	
変更概要	Design/Specification	☐ Design	☐ Electrical	☐ Mechanical
	Wafer Fab	☐ Site	☐ Process	☐ Material
	Wafer Bump	☐ Site	☐ Process	☐ Material
	☒ Assembly	☐ Site	☐ Process	☒ Material
	Test	☐ Site	☐ Process	
	Others	☐ Packing/Shipping/Labeling		☐ -
変更内容	初版連絡の下記変更内容について変更取消の連絡になります。 STATSChipPAC 社製造 PBGA パッケージ 一部製品 代替Substrate 部材追加 現行 : 認定 Substrate 変更後 : 認定 Substrate, Doosan 社製 Substrate			
対象製品	対象製品リスト参照			
変更時期	－			
品質認定試験	☒ 計画		☐ 終了	
製品表示	☒ 変更無し		☐ 変更あり	
備考	－			

変更内容

内容：今回のお知らせは、2011年4月29日発行 初版 PCN20110429000にて連絡しました下記変更について、変更取消の連絡になります。現行の部材供給業者復旧のため、本変更実施を取り消します。今後、本変更部材供給業者も含め新規部材供給業者を使用する際には、新規PCNにて、信頼性試験計画及びサンプル提供と共に別途お知らせいたします。

弊社 ASP(アプリケーションスペシフィックプロダクト)/HPA(ハイパフォーマンスアナログ) STATSChipPAC社サイト製造 PBGAパッケージ 一部製品について、震災状況下での供給能力確保の為、代替Substrate部材追加の連絡になります。一部部材の供給制限のため、認定試験終了次第、本代替部材の追加変更は直ちに実施予定です。認定終了前のいかなる製品出荷についても、事前顧客承認が必要になります。尚、今回の変更で、製品についての互換性(寸法/公差), 外観, 動作特性, 品質, 信頼性への影響はありません。

変更内容

Substrate 部材

現行

認定 Substrate

変更後

認定 Substrate
Doosan 社製 Substrate

理由：供給能力確保の為

製品表示

この変更による製品捺印、出荷ラベルの変更はありません。部材識別については、弊社標準のロット追跡及び製造手順によりトレーサビリティは確保されます。

対象製品リスト

対象製品名				
D610A003BZDP225	TMS320C6711DGDPA200	TMS320C6713BGDP225	TMS320TC1110ZPC	TMS32C6713BGDPA200
OMAP5910JZDY2	TMS320C6711DZDP200	TMS320C6713BGDP300	TMS320TC1110ZPJ	TMS32C6713BZDPA200
TLK3134ZEL	TMS320C6711DZDP250	TMS320C6713BZDP225	TMS320TC1120AZDP	TNETV1055NNZDW
TLK3138ZDU	TMS320C6712DGDPA150	TMS320C6713BZDP300	TMS32C6711DGDPA167	
TLK3142ZEL	TMS320C6712DZDP150	TMS320C6727ZDH300	TMS32C6711DZDPA167	

信頼性試験

信頼性試験計画

信頼性試験期間	開始	—	終了	2011 年 7 月 20 日
---------	----	---	----	-----------------

信頼性試験 - 試料構成詳細

Qualification Device:	F761637AGXM	Substrate:	Doosan Substrate
Package:	PBGA	Site(s):	CPK

信頼性試験計画

Reliability Test	Condition / Duration	Sample Size
Material Property Comparison	Specification Review	per spec
Preconditioning	JEDEC L-4/260C	539
High Temperature Storage Life	150C, 600hrs Note (1)	45
Temperature Cycle	-55C/125C, 1000cyc	231
Temperature Humidity Bias	85C/85%RH, 600hrs Note(1)	77
UnBiased HAST	130C/85%RH, 96hrs	231

Note (1): Qualification Device release at 600hrs, other device Qual by Similarity/Bridge at 1000hrs